



平成 19 年 6 月期 第 1 四半期財務・業績の概況（連結）

平成 18 年 11 月 16 日



上場会社名 株式会社アルバック

(コード番号：6728 東証第一部)

(URL <http://www.ulvac.co.jp/>)

代 表 者 役職・氏名 代表取締役社長 諏訪 秀則

問合せ先責任者 役職・氏名 専務取締役 常見 佳弘 TEL：(0467) 89-2033

1. 四半期財務情報の作成等に係る事項

- | | |
|--------------------------|---|
| ① 会計処理の方法における簡便な方法の採用の有無 | 無 |
| ② 最近連結会計年度からの会計処理の変更の有無 | 無 |
| ③ 連結及び持分法の適用範囲の異動の有無 | 有 |

2. 平成 19 年 6 月期第 1 四半期財務・業績の概況（平成 18 年 7 月 1 日～平成 18 年 9 月 30 日）

(1) 経営成績（連結）の進捗状況

(百万円未満は四捨五入)

	売上高		営業利益		経常利益		四半期（当期）純利益	
	百万円	%	百万円	%	百万円	%	百万円	%
19 年 6 月期第 1 四半期	60,340	49.4	4,277	510.2	4,365	615.0	2,001	-
18 年 6 月期第 1 四半期	40,398	0.7	701	△72.8	610	△76.1	81	△94.0
(参考) 18 年 6 月期	212,454	7.9	14,796	△3.3	14,782	18.8	8,102	13.4

	1 株当たり四半期（当期）純利益		潜在株式調整後 1 株当たり四半期（当期）純利益	
	円	銭	円	銭
19 年 6 月期第 1 四半期	46	65	-	-
18 年 6 月期第 1 四半期	1	88	-	-
(参考) 18 年 6 月期	188	87	-	-

(注) 売上高、営業利益、経常利益、四半期（当期）純利益の%表示は、対前年同四半期比増減率です。

※ 上記経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等につきましては、添付資料の 4 ページを参照ください。

(2) 財政状態（連結）の変動状況

	総資産	純資産	自己資本比率	1 株当たり純資産	
	百万円	百万円	%	円	銭
19 年 6 月期第 1 四半期	283,317	88,894	29.6	1,954	71
18 年 6 月期第 1 四半期	226,420	72,940	32.2	1,700	06
(参考) 18 年 6 月期	269,401	87,627	30.7	1,929	19

(3) 連結キャッシュ・フローの状況

	営業活動による キャッシュ・フロー	投資活動による キャッシュ・フロー	財務活動による キャッシュ・フロー	現金及び現金同等物 期末残高
	百万円	百万円	百万円	百万円
19 年 6 月期第 1 四半期	2,936	△5,582	7,813	16,244
18 年 6 月期第 1 四半期	△5,328	△2,454	1,976	11,066
(参考) 18 年 6 月期	8,626	△21,334	4,414	10,515

※ 上記財政状態（連結）の変動状況に関する定性的情報等につきましては、添付資料の 5 ページを参照ください。

【参考】

平成 19 年 6 月期の連結業績予想（平成 18 年 7 月 1 日～平成 19 年 6 月 30 日）

中間期及び通期の連結業績予想につきましては、平成 18 年 8 月 16 日発表の数値に変更はありません。

(注意事項)

連結業績予想につきましては、現時点で入手可能な情報に基づき判断しており、多分に不確定な要素を含んでおります。実際の連結業績等は、業況の変化等により予想数値と異なる場合があります。

【企業集団の状況】

当社グループは、当社、子会社49社、関連会社6社からなり、真空技術が利用されているさまざまな産業分野に多岐に渡る製品を生産財として提供している真空総合メーカーであります。

事業内容は、真空技術を基盤として、真空装置・機器やサービスを提供する真空関連事業と、真空技術の周辺技術を基盤として、主に材料や表面解析等を提供するその他の事業に区分できます。

各々の事業区分ごとの主要製品は、下表のとおりであります。

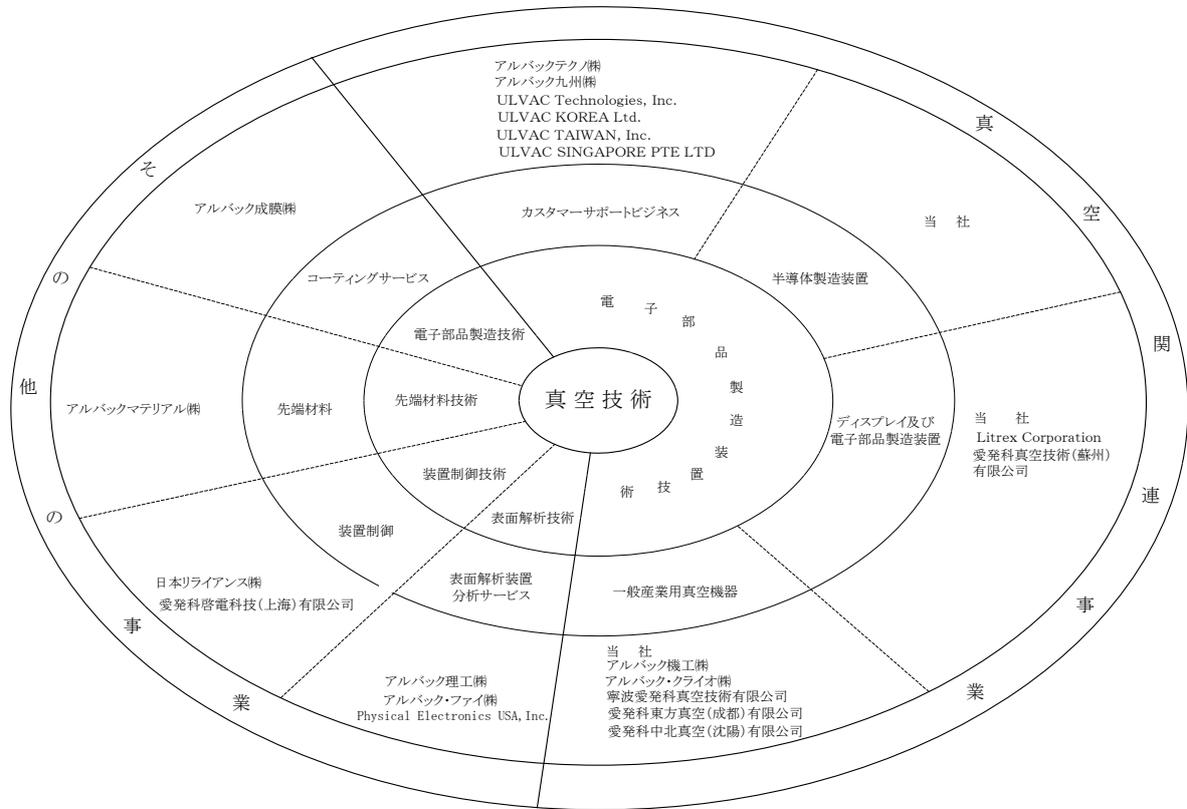
事業区分		主要製品
真空関連事業	ディスプレイ及び電子部品製造装置	スパッタリング装置、プラズマCVD装置、有機EL製造装置、真空蒸着装置、エッチング装置、固体レーザーアニール装置、インクジェットプリンティング装置、スクリーン印刷機、液晶滴下・真空貼り合せ装置、PDP点灯試験器
	半導体製造装置	スパッタリング装置、エッチング装置、イオン注入装置、レジストストリッピング装置、メタルCVD装置、減圧CVD装置、ウェーハ前処理（自然酸化膜除去等）装置、ウェーハパンプ検査装置
	コンポーネント	真空ポンプ（ドライポンプ、油回転ポンプ、メカニカルブースタポンプ、油拡散ポンプ、スパッタイオンポンプ、クライオポンプ、ターボ分子ポンプ）、各種真空計、ヘリウムリークディテクタ、各種ガス分析計、表面形状測定装置、非接触型金属膜厚測定機、各種電源、成膜コントローラ、各種真空バルブ、各種真空部品（導入端子、真空覗き窓、真空用マニピレータ他）、真空搬送ロボット／真空搬送コアシステム
	その他	超高真空装置、カーボンナノチューブCVD装置、グラファイトナノファイバーCVD装置、MOCVD装置、超高真空排気装置、スパッタリング装置、MBE装置、イオンビーム応用装置、真空溶解炉、真空熱処理炉、真空焼結炉、真空巻取蒸着装置、蒸着重合装置、真空ろう付炉、凍結真空乾燥装置、真空蒸留装置
その他の事業	スパッタリングターゲット材料、蒸着材料、チタン・タンタル加工品、高融点活性金属（Ta、Nb、W、Mo）、表面処理・精密洗浄、超微粒子（ナノメタルインク）、オージェ電子分光分析装置、X線光電子分光分析装置、二次イオン質量分析装置、熱分析・熱物性測定装置、近赤外線イメージ炉応用機器、各種産業機械駆動用制御装置、高電圧インバータ装置、電源再生コンバータ装置、無停電電源装置、非接触測長装置	

また、当社企業集団の主要製品の概要は、次のとおりであります。

主要製品	概要
スパッタリング装置	高真空中で金属やシリサイド等の金属の材料に、高エネルギーのアルゴン原子をぶつけ、それに叩かれ飛び出してくる金属原子を付着させて成膜する装置。
CVD装置	つくる薄膜の種類に応じて原料をガス状態で供給し、下地膜の表面における化学触媒反応によって膜を堆積させる装置。
エッチング装置	真空中に被エッチング材料を入れ、その材料に合わせてエッチングガスを導入しプラズマ化し、エッチング種が被エッチング材料に吸着されると表面化学反応を起こし、エッチング生成物を排気除去する装置。
真空蒸着装置	真空中で特定の物質を熱し、そこから蒸発する原子や分子をより温度の低い面に凝縮させて、表面に膜を形成する装置。
真空熱処理炉	真空中で各種金属の焼入、ろう付、焼戻、容体化、時効、磁性処理等を行う装置。

以上のような装置により、携帯電話、パーソナルコンピューター、情報携帯端末（PDA）、携帯音楽プレイヤー、太陽エネルギー利用機器、光通信デバイス、デジタル家電、薄型テレビ、自動車等の最終製品を構成するディスプレイ及び電子部品等が生み出されております。

当社グループは、装置・機器だけでなく、材料、解析評価、サービスを総合的に「アルバックソリューションズ」として提供することにより、グループとしてのシナジー効果を発揮しております。また、真空装置・機器とプロセス技術を組み合わせた顧客への提案も行っております。アルバックソリューションズを構成する当社及び主な関係会社は、次のとおりであります。



アルバックソリューションズの一環として、カスタマーズサポート（CS）ソリューションズパッケージは、フィールドサービスの他、装置改良改善（CIP）活動、部品提供、成膜材料提供、装置部品再生、洗浄及び表面処理、分析サービス、中古機提供、オペレーティングリース等の総合サービスを提供しております。

【経営成績（連結）の進捗状況に関する定性的情報等】

当社グループの主要なお客様であるFPD（フラットパネルディスプレイ）、電子部品及び半導体関連業界の設備投資は、韓国、台湾、日本を中心に、大画面（液晶、プラズマ）テレビ、携帯電話、携帯音楽プレイヤー等のデジタル家電関連の投資が行われました。また、エネルギー・環境関連では、環境対応型のハイブリッドカー関連や太陽電池への設備投資が新たに開始されました。

当社グループは、このような経営環境に対処するため、独創的な新製品を競合他社に先駆けて市場に投入し、アルバックグループの総合力を発揮するアルバックソリューションズの推進による積極的な受注活動を行ってまいりました。また、成長する地域である中国、韓国、台湾だけではなく日本国内への積極的な投資を実施する等、事業の拡大を行ってまいりました。さらに、お客様からの価格引き下げ要求が継続する中、生産改革第2段階の推進によりコストダウンや生産効率の向上を図るとともに、諸経費の削減を継続することで固定費の圧縮を進めてまいりました。

その結果、当四半期の業績につきましては、受注高は697億16百万円と前年同期と比べて229億76百万円（49.2%）増加し、売上高は603億40百万円と前年同期と比べて199億42百万円（49.4%）増加いたしました。当四半期の損益につきましては、経常利益は43億65百万円と前年同期と比べて37億54百万円（615.0%）増加いたしました。なお、四半期純利益は20億1百万円となりました。

【真空関連事業】

真空関連事業の品目別の状況は下記のとおりです。

（ディスプレイ及び電子部品製造装置）

韓国、台湾、日本において第5～第8世代の液晶ディスプレイや中小型液晶ディスプレイ等の設備投資が行われ、液晶ディスプレイ用枚葉式スパッタリング装置や縦型枚葉式スパッタリング装置の「SMD シリーズ」の受注、売上が好調を維持するだけでなく、枚葉式プラズマCVD装置「CMD シリーズ」、インライン式スパッタリング装置「SDPシリーズ」の売上が好調でした。また、電子部品製造装置では、パワーデバイス用のスパッタリング装置等の受注や売上が好調を維持しました。

（半導体製造装置）

デジタル家電関連では、携帯電話、携帯音楽プレイヤーやデジタルカメラ等に使用されるフラッシュメモリやDRAM関連の設備投資が積極的に行われました。生産性が向上した300mmウエーハ用スパッタリング装置「ENTRONTMEX シリーズ」やエッチング装置「NE シリーズ」、バッチタイプ自然酸化膜除去装置「RISE シリーズ」等の受注や売上が好調でした。

（コンポーネント）

主に液晶ディスプレイ等のFPD製造装置向けにドライポンプの受注が好調でした。そのほか、電子部品や自動車等の用途向けの真空ポンプ、自動車業界を中心に真空計等の計測器関連及びFPD等の成膜工程での膜厚測定機の受注も好調でした。

（その他）

一般産業用としてハイブリッドカー向けをはじめとする真空蒸着装置や希土類磁石製造用の真空熱処理炉、真空溶解炉の売上が堅調でした。

その結果、真空関連事業の受注高は609億62百万円、受注残高は1,221億99百万円、売上高は531億11百万円となりました。また、営業利益は42億46百万円となりました。

【その他の事業】

その他の事業につきましては、アルバックソリューションズを生かしたグループ一体となった積極的な受注活動を行いました。韓国、台湾、日本を中心にメタル等のFPD及び半導体関連用スパッタリングターゲット材料や部品洗浄等の材料ビジネスの受注や売上が堅調でした。

その結果、受注高は87億54百万円、受注残高は80億83百万円、売上高は72億29百万円となりましたが、装置制御関連事業で売上が翌四半期以降にずれ込んだため、1億44百万円の営業損失となりました。

なお、上記金額には消費税等は含まれておりません。

【財政状態(連結)の変動状況に関する定性的情報等】

①当四半期の財政状態の変動状況

総資産は、前連結会計年度末に比べ139億16百万円増加して、2,833億17百万円となりました。現金及び預金が61億58百万円、たな卸資産が58億13百万円増加したこと等によります。

純資産は、前連結会計年度末に比べ12億67百万円増加して、888億94百万円となりました。利益剰余金等の増加によります。

以上により、自己資本比率は29.6%となりました。

②当四半期のキャッシュ・フローの状況

(営業活動によるキャッシュ・フロー)

税金等調整前四半期純利益と減価償却費のプラス要因に対し、法人税等の支払額等マイナス要因があり、29億36百万円の収入となりました。

(投資活動によるキャッシュ・フロー)

投資有価証券、有形・無形固定資産の取得等により、55億82百万円の支出となりました。

(財務活動によるキャッシュ・フロー)

投資活動によるキャッシュ・フローの支出に対応し、長期借入金等により、資金調達をいたしました。長期借入金の返済による支出、配当金の支払いもあり、財務活動によるキャッシュ・フローは、78億13百万円の収入となりました。

以上により、現金及び現金同等物は、前連結会計年度末に比べて57億29百万円増加し、162億44百万円となりました。

【四半期連結貸借対照表】

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期末)		前連結会計年度 (平成18年6月末)		
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)	
(資産の部)					
I 流動資産					
1. 現金及び預金		17,143		10,986	
2. 受取手形及び売掛金		82,975		83,430	
3. たな卸資産		80,554		74,741	
4. 繰延税金資産		4,447		4,146	
5. その他		4,087		5,644	
6. 貸倒引当金		△203		△227	
流動資産合計		189,003	66.7	178,738	66.3
II 固定資産					
(1)有形固定資産					
1. 建物及び構築物	43,516		43,960		
減価償却累計額	18,930	24,586	19,132	24,829	
2. 機械装置及び運搬具	41,697		42,208		
減価償却累計額	23,613	18,085	22,954	19,253	
3. 工具器具及び備品	11,208		10,933		
減価償却累計額	8,582	2,626	8,292	2,641	
4. 土地		9,185		9,115	
5. 建設仮勘定		9,587		4,969	
有形固定資産合計		64,069	22.6	60,807	22.6
(2)無形固定資産					
1. のれん		2,087		2,197	
2. その他		3,510		3,339	
無形固定資産合計		5,597	2.0	5,536	2.1
(3)投資その他の資産					
1. 投資有価証券		15,918		14,910	
2. 差入保証金		1,357		1,336	
3. 繰延税金資産		3,748		3,678	
4. その他		3,735		4,486	
5. 貸倒引当金		△111		△91	
投資その他の資産合計		24,648	8.7	24,320	9.0
固定資産合計		94,313	33.3	90,663	33.7
資産合計		283,317	100.0	269,401	100.0

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期末)		前連結会計年度 (平成18年6月末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(負債の部)				
I 流動負債				
1. 支払手形及び買掛金	73,925		68,410	
2. 短期借入金	31,206		24,908	
3. コマーシャル・ペーパー	10,000		10,000	
4. 未払法人税等	2,351		5,002	
5. 前受金	19,503		20,785	
6. 繰延税金負債	0		1	
7. 賞与引当金	1,677		1,484	
8. 役員賞与引当金	117		294	
9. 製品保証引当金	2,778		2,769	
10. その他	13,909		12,811	
流動負債合計	155,466	54.9	146,464	54.4
II 固定負債				
1. 社債	200		200	
2. 長期借入金	26,303		23,149	
3. 退職給付引当金	10,644		10,269	
4. 役員退職慰労引当金	654		1,104	
5. その他	1,156		588	
固定負債合計	38,957	13.7	35,311	13.1
負債合計	194,423	68.6	181,774	67.5

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期末)		前連結会計年度 (平成18年6月末)	
	金額 (百万円)	構成比 (%)	金額 (百万円)	構成比 (%)
(純資産の部)				
I 株主資本				
1. 資本金	13,468		13,468	
2. 資本剰余金	14,695		14,695	
3. 利益剰余金	52,621		51,929	
4. 自己株式	△6		△6	
株主資本合計	80,778	28.5	80,085	29.7
II 評価・換算差額等				
1. その他有価証券評価 差額金	1,482		1,537	
2. 為替換算調整勘定	1,591		1,134	
評価・換算差額等合計	3,073	1.1	2,671	1.0
III 少数株主持分	5,043	1.8	4,870	1.8
純資産合計	88,894	31.4	87,627	32.5
負債及び純資産合計	283,317	100.0	269,401	100.0

【四半期連結損益計算書】

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期末)			前年同四半期 (平成18年6月期第1四半期)		
	金額 (百万円)		百分比 (%)	金額 (百万円)		百分比 (%)
I 売上高		60,340	100.0		40,398	100.0
II 売上原価		48,805	80.9		33,486	82.9
売上総利益		11,535	19.1		6,912	17.1
III 販売費及び一般管理費						
1. 販売費	2,478			2,385		
2. 一般管理費	4,780	7,258	12.0	3,826	6,211	15.4
営業利益		4,277	7.1		701	1.7
IV 営業外収益						
1. 受取利息	19			8		
2. 受取配当金	9			34		
3. 受取手数料	71			65		
4. 受取賃貸料	29			24		
5. 為替差益	-			39		
6. その他	575	703	1.1	45	214	0.5
V 営業外費用						
1. 支払利息	192			173		
2. 貸貸資産経費	63			47		
3. たな卸資産評価損	22			-		
4. 持分法による投資損失	39			54		
5. その他	300	616	1.0	31	305	0.7
経常利益		4,365	7.2		610	1.5

区分	当四半期 (平成19年6月期第1四半期)			前年同四半期 (平成18年6月期第1四半期)		
	金額 (百万円)		百分比 (%)	金額 (百万円)		百分比 (%)
VI 特別利益						
1. 貸倒引当金戻入額	17			-		
2. 持分変動利益	4	21	0.0	-	-	-
VII 特別損失						
1. 固定資産除却損	284			-		
2. 投資有価証券評価損	29	313	0.5	-	-	-
税金等調整前四半期純利益		4,072	6.7		610	1.5
法人税、住民税及び事業税	2,313			459		
法人税等調整額	△309	2,004	3.3	△19	441	1.1
少数株主利益		68	0.1		89	0.2
四半期純利益		2,001	3.3		81	0.2

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる事項】

1. 連結の範囲に関する事項

- (1) 連結子会社の数 25 社・・・当四半期において、Physical Electronics USA, Inc.、愛発科（中国）投資有限公司の 2 社を、重要性が増したため連結の範囲に加えております。
- (2) 非連結子会社の数 24 社・・・当四半期において、ULVAC KOREA Research Center, Ltd、ULVAC TAIWAN RESEARCH CENTER INC、ULVAC MALAYSIA SDN. BHD.、シグマテクノス(株)の 4 社を非連結子会社といたしました。
- (3) 非連結子会社について連結の範囲から除いた理由・・・非連結子会社は、いずれも小規模会社であり、総資産、売上高、四半期純損益、利益剰余金等の観点からみて重要な影響を及ぼしておりません。

2. 持分法の適用に関する事項

持分法適用関連会社の数 3 社・・・持分法を適用していない非連結子会社 (24 社) 及び関連会社 (3 社) は、いずれも小規模会社であり、四半期純損益、利益剰余金等の観点からみて影響が軽微であり、重要性がないため持分法の適用から除外しております。

3. 連結子会社の決算日については、中間連結会計期間に準じて作成しております。

【会計処理基準に関する事項】

1. 重要な資産の評価基準及び評価方法

- (1) たな卸資産 …… 主として個別法による原価法によっております。
- (2) 有価証券 …… 満期保有目的の債権は償却原価法（定額法）、その他有価証券は、時価のあるものは四半期末日の市場価格等に基づく時価法、時価のないものは移動平均法による原価法。
- (3) デリバティブ …… 時価法。

2. 重要な減価償却資産の減価償却方法

- (1) 定率法その他、当社の研究開発部門・富士裾野工場及び賃貸用有形固定資産は定額法。
- (2) 平成 10 年 4 月以降に取得した建物は定額法。
- (3) 少額資産は 3 年均等償却。
- (4) 無形固定資産は定額法。

3. 重要な引当金の計上基準

- (1) 貸倒引当金 …… 債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。
- (2) 賞与引当金 …… 従業員に支給する賞与の当四半期負担分として、支給対象期間に基づく支給見込額を計上しております。
- (3) 役員賞与引当金 …… 役員に支給する賞与の当四半期負担分として、支給見込額を計上しております。
- (4) 製品保証引当金 …… 販売された製品の保証に伴う費用の支出に備えるため設定したもので、過去の発生実績率に基づいて計上しております。
- (5) 退職給付引当金等 …… 従業員の退職給付に備えるため、当四半期末において発生していると認められる額を計上しております。役員退職慰労引当金については、年間計上見込額の当四半期分を見込んで計上しております。

4. 外貨建金銭債権債務は、中間連結会計期間末に準じて処理しております。

5. 消費税等の会計処理は、税抜方式を採用しております。

【セグメント情報】

事業の種類別セグメント情報

(単位：百万円)

科目	当四半期（平成19年6月期第1四半期）				
	真空関連事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	53,111	7,229	60,340	-	60,340
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	133	1,820	1,953	(1,953)	-
計	53,244	9,049	62,293	(1,953)	60,340
営業費用	48,998	9,193	58,191	(2,129)	56,063
営業利益又は営業損失(△)	4,246	△144	4,102	175	4,277

科目	前年同四半期（平成18年6月期第1四半期）				
	真空関連事業	その他の事業	計	消去又は全社	連結
I. 売上高及び営業損益					
売上高					
(1)外部顧客に対する売上高	34,735	5,663	40,398	-	40,398
(2)セグメント間の内部売上高又は振替高	33	1,328	1,361	(1,361)	-
計	34,768	6,991	41,759	(1,361)	40,398
営業費用	34,095	6,993	41,087	(1,390)	39,697
営業利益又は営業損失(△)	673	△2	671	30	701

(注) 1. 事業の区分は、主要製品の区分によっております。

2. 各事業区分の主要製品は、企業集団の状況の記載と同様であります。

平成19年6月期 第1四半期財務・業績の概況（連結）補足資料

【受注及び販売の状況】

(1) 受注高及び受注残高

受注高

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (平成19年6月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年6月期第1四半期)	
	販売高	割合	販売高	割合
真空関連事業	60,962		39,898	
その他の事業	8,754		6,843	
合計	69,716		46,740	

受注残高

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (平成19年6月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年6月期第1四半期)	
	販売高	割合	販売高	割合
真空関連事業	122,199		92,223	
その他の事業	8,083		6,533	
合計	130,282		98,757	

(注) 消費税等は含んでおりません。

(2) 販売実績

(単位：百万円)

事業の種類別セグメントの名称	当四半期 (平成19年6月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年6月期第1四半期)	
	販売高	割合	販売高	割合
真空関連事業	53,111		34,735	
その他の事業	7,229		5,663	
合計	60,340		40,398	

(注) 1. 消費税等は含んでおりません。

2. 真空関連事業の主な品目別販売実績及び当該販売実績に対する割合

(単位：百万円)

品目	当四半期 (平成19年6月期第1四半期)		前年同四半期 (平成18年6月期第1四半期)	
	販売高	割合	販売高	割合
ディスプレイ及び電子部品 製造装置	35,344	66.6 %	18,401	53.0 %
半導体製造装置	7,484	14.1	7,356	21.2
コンポーネント	6,769	12.7	6,491	18.7
その他	3,513	6.6	2,487	7.1
計	53,111	100.0	34,735	100.0

(注) コンポーネントは、真空ポンプ、真空計測器、部品・電源・ソフトであります。